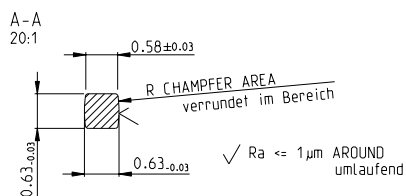
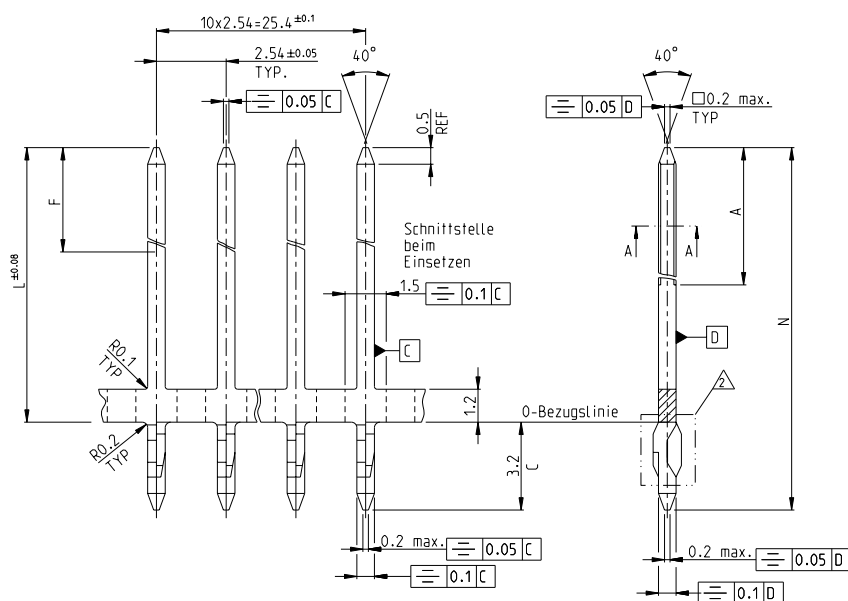


LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWA	APV
			F1	Zeichnung wird NEUTRAL	31JUL1990	Beu	-
			F2	Material bleifrei	13SEP2004	Stein	-
			F3	Bem. 2 korrigiert	26AUG2005	Beu	-
			F4	New drawing created / note 3 updated	19MAR2008	Maas	2/12/08



- 7 APPLICATION TOOL: X-Y- MACHINE 2-872 020-9
 Verarbeitungsverfahren: X-Y-Einsetzmaschine 2-872 020-9
- 6 1.2 µm TIN IN AREA "F" ABOVE
 1.2 µm NICKEL IN AREA "L"
 AREA "C": 5.0 µm TIN ABOVE 1.2 µm NICKEL
 1.2 µm Zinn im Bereich "F" über
 1.2 µm Nickel im Bereich "L"
 Im Bereich "C": 5.0 µm Zinn über 1.2 µm Nickel
- 5 TE-SPEC. 108-18002
 TE-Spez.
- 4 SOLDERABILITY ACC. TO DIN40046
 Lötbarkeit nach
- 3 REEL UNIT 50000 PINS Rolleneinheit 50000 Stifte
 REEL-Ø 600mm Rollen-Ø 600mm
 REEL THICKNESS Rollendicke
- 14mm für 1-929958-1
 14mm für 2-929958-1
 19mm für 1-929958-2
 16mm für 2-929958-2
- 
- Ø22mm
- 2 PRESS-IN ZONE FOR 1.6mm PCB REQUIREMENTS ON THE PCB-hole: Einpresszone für 1.6mm Leiterplatten-Anforderung an Leiterplatten-Bohrung:
- Bohrdurchmesser / HOLE DIAMETER: 1.0±0.025mm
 Cu-Dicke / Cu-THICKNESS: 25-50 µm
 Sn-Dicke / Sn-THICKNESS: 14-20 µm
 Fertiglötlöhdurchmesser / FINISHED HOLE DIAMETER: 0.9±0.05mm
- 1 0.2 µm Au IN AREA "F" ABOVE
 1.2 µm NICKEL IN AREA "L"
 IN AREA "C": 5.0 µm TIN ABOVE
 1.2 µm NICKEL
 0.2 µm Au im Bereich "F" über
 1.2 µm Nickel im Bereich "L"
 Im Bereich "C": 5.0 µm Zinn über
 1.2 µm Nickel

NOT FOR NEW APPLICATIONS
Nicht für Neuanwendungen

	CuSn4/F65	7	7	13.2	10	2-929 958-2
	CuSn4/F65	7	6	13.2	10	1-929 958-2
	CuSn4/F65	6.7	6.7	11.45	8.25	2-929 958-1
	CuSn4/F65	6.7	6	11.45	8.25	1-929 958-1
FINISH	MATERIAL	"A"	"F"	"N"	"L"	ORDER NO Bestell-Nr.
		DIMENSIONS				

[illegible]